

## 奥野製薬工業

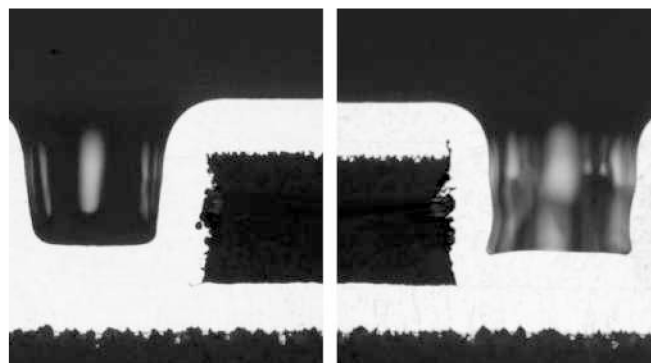
# 微細配線形成に対応

### 硫酸銅 メッキ薬品 メッキ膜厚均一化

奥野製薬工業（大阪市中央区、奥野和義社長）は、半導体パッケージ基板やプリント基板の微細な配線形成に対応した硫酸銅メッキ薬品を開発した。高速・大容量通信を可能にするサーバー向けに、高密度で高性能な半導体パッケージ基板や高密度プリント基板が求められている。電子部品業界向けに提案を強化する。

開発した半導体パッケージ基板向けメッキ薬品「トップルチナGAP」は、基板の上下層を接続するビアホール内部を銅メッキで充填する。メッキ膜の厚みのバラつきを従来比30%低減させ、配線

「ナGL」も開発した。基板を貫通するスルーホール内部へ均一にメッキを施すことができる。ビアホールに対しても穴の形状に沿って厚みの均一なメッキが可能になる。



また奥野製薬は今夏、台湾新北市に新拠点を設ける。台湾では▲スルーホール内部へ均一にメッキを施す「トップルチナGL」（左）と従来品

アルミニウムやプラスチックなど装飾用の表面処理薬品が主力だったが、今後は、付加価値の高い電子部品業界の顧客対応を強化する。新拠点には分析・試験作用の実験室を設け、半導体やフレキシブル基板などの微細メッキ向け薬品の拡販を狙う。すでに国内外で販売する、プリント基板などの内層銅と高い接続信頼性が得られる微細配線用無電解銅メッキ薬品も合わせて、次世代メッキ薬品を一括して提案する。